

## 抵抗体用 電極ペースト

型番 Type	導電成分 Conductor	比抵抗 Specific resistance $\mu\Omega\cdot\text{cm}$	粘度 Viscosity Pa·s	焼成膜厚* Fired Thickness $\mu\text{m}$	塗布面積 Coverage $\text{cm}^2/\text{g}$	適用抵抗体 (シリーズ) Adapted Resistor				推奨焼成条件 Sintering schedule
						CuNi系		LaB <sub>6</sub> 系		
						DH	D	A	N	
DC019	Cu	$\leq 4$	50-100	12-15	56	○	○	×	×	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
DC019U (裏面電極用)	Cu	$\leq 4$	30-50	6-8	50	○	○	×	×	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
DC014E	Cu	$\leq 3$	50-100	12-15	52	×	×	○	×	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
HS201 (AlN基板用)	Ag	$\leq 4$	50-100	12-15	52	×	×	×	○	900 °C 10min In Air

対応基板：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (HS201以外), 塗布方法：スクリーン印刷, 保管条件：冷蔵

Substrate：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Except for HS201), Coating method：Screen printing, Storage condition：Refrigeration

\* 標準スクリーン版使用時 メッシュ：#250-φ30μm, 乳剤厚：10μm

\* When using the standard screen printing plate Mesh：#250-φ30μm, Thickness of emulsion：10μm

## 抵抗体用 オーバーコートガラスペースト

型番 Type	焼成膜色味 Color	粘度 Viscosity Pa·s	焼成膜厚 Fired Thickness Mmt	塗布面積 Coverage $\text{cm}^2/\text{g}$	適用抵抗体 (シリーズ) Adapted Resistor				推奨焼成条件 Sintering schedule
					CuNi系		LaB <sub>6</sub> 系		
					DH	D	A	N	
OCG02	灰色	30-80	15-18	133	○	○	○	×	650 °C 10min In N <sub>2</sub>
OCG10CLD	透明	30-80	15-18	150	○	○	○	×	900 °C 10min In N <sub>2</sub>

対応基板：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 塗布方法：スクリーン印刷, 保管条件：冷蔵

Substrate：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Coating method：Screen printing, Storage condition：Refrigeration

\* 標準スクリーン版使用時 メッシュ：#250-φ30μm, 乳剤厚：10μm

\* When using the standard screen printing plate Mesh：#250-φ30μm, Thickness of emulsion：10μm